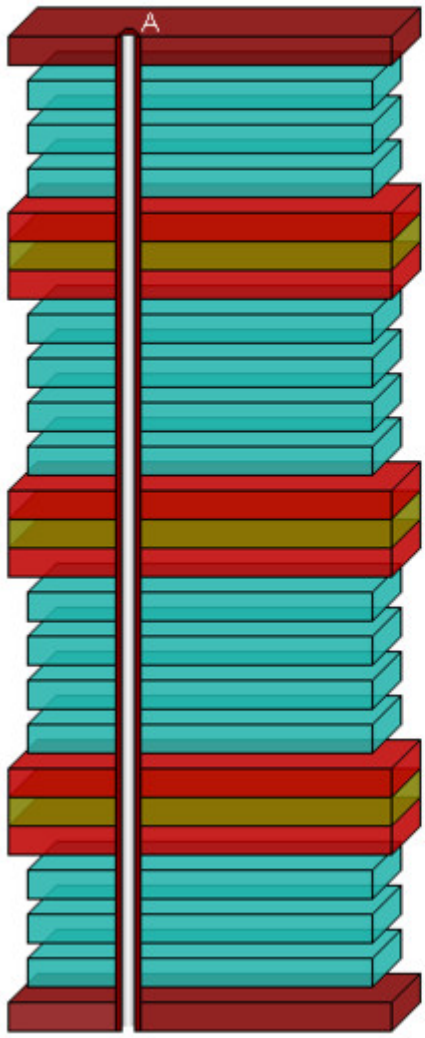
Dickkupfer-Multilayer 8 Lagen - 2,4 mm

Lagenaufbau



Ebene	Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
	Cu+galv.Cu		70+25	
1	Prepreg	0.081		1080
	Prepreg	0.081		1080
	Prepreg	0.081		1080
	Cu		105	
2	Tr-Lam	0.25		
	Cu		105	
3	Prepreg	0.081		1080
	Prepreg	0.081		1080
	Prepreg	0.081		1080
	Prepreg	0.081		1080
	Cu		105	
4	Tr-Lam	0.25		
	Cu		105	
5	Prepreg	0.081		1080
	Prepreg	0.081		1080
	Prepreg	0.081		1080
	Prepreg	0.081		1080
	Cu		105	
6	Tr-Lam	0.25		
	Cu		105	
7	Prepreg	0.081		1080
	Prepreg	0.081		1080
	Prepreg	0.081		1080
	Cu+galv.Cu		70+25	
8				

Presslingsdicke*	2,34	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstoppmaske*	2,45	+/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com

Dickkupfer-Multilayer 8 Lagen - 2,4 mm

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 gefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 500 µm
	Viapad-Ø	≥ 950 µm
Leiterbild Außenlagen		
	Leiterbreite bei 50 µm Grundkupfer	≥ 160 µm
	Leiterabstand bei 50 µm Grundkupfer	≥ 215 µm
Standard	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer	≥200 µm
	Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 260 µm
	Leiterbreite bei 105 µm Grundkupfer	≥250 µm
	Leiterabstand bei 105 µm Grundkupfer	≥ 320 µm
Leiterbild Innenlagen		
	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer	≥ 145 µm
	Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 150 µm
Standard	Leiterbreite bei 105 µm Grundkupfer	≥175 µm
	Leiterabstand bei 105 µm Grundkupfer	≥ 190 µm

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com